

企业集采长先/CX8000LD 免洗有铅锡膏

产品名称	企业集采长先/CX8000LD 免洗有铅锡膏
公司名称	深圳市长先科技实业有限公司
价格	62.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:snpb 用途:元器件焊接
公司地址	深圳市南山区登良路南油第二工业区205栋8层805-A (恒裕中心A座)
联系电话	86 0755 26689086 13480869562

产品详情

一、 特点概述

- ∅ 润湿性能优越，适合各种类型的pcb表面处理镀层。对大焊盘和细间距ic等焊盘上锡优秀，即使对qfn、镀ni等难焊部件也同样表现良好。
- ∅ 该系列免清洗锡膏可经受高的预热、保温温度和长的预热、保温时间，即使2~3次的回流焊接后仍能保持焊点光亮，残留透明，确保产品的长期使用的可靠性。
- ∅ 抗热坍塌能力优异，降低了由于坍塌造成锡球和连锡等焊接缺陷，特别是极大的降低了chip元件侧面锡球的发生，触变性能好，脱模顺畅，连续印刷图形完整度好
- ∅ 低卤配方设计，降低室温下锡粉和助焊剂的反应，空洞率超过ipc锡膏空洞规定的第三类标准，即使是使用渐升式温度曲线或长的回流时间，也能保证焊接质量
- ∅ 残留物柔软、少而透明，扩散均匀，无腐蚀，残留物不龟裂，无气泡，可经受2~3次回流焊接
- ∅ 储存和运输途中不分层，不发干，不流动，表面油亮细腻，印刷过程中流动性好，不发干，多次印刷的脱模性能好，印刷停顿长时间后的再次印刷性能好，无需再次搅拌

一、 规格成份

型号	cx8000ld	
	项目	规格
1	外观	灰色均匀膏体
2	气味	无刺激性气味
3	主要成份	sn55pb45锡粉
		助焊膏
4	助焊剂含量	10%~13%
5	锡粉颗粒	25~45 μ m

助焊膏成份

松香	合成树脂	溶剂	添加剂	活性剂	表面活性剂	触变剂
----	------	----	-----	-----	-------	-----

三、物理特性

型号	cx8000ld
合金熔点	snpb 180-190
卤素含量	<900ppm
绝缘电阻	>1.0e+8
电迁移	通过
铜镜实验	通过
粘度	180 ± 30
可焊性	可焊性优良，粘接力强
扩展率	>90%
冷坍塌	<0.2mm
热坍塌	<0.2mm
锡球实验	1级
润湿实验	1级
操作时间	8h

四、 包装和标示

1) 包装以罐装为1个单位，每罐500克，盖子分内、外盖。

2) 交货时将上述容器装在泡沫保温箱里运输，10kg/箱，低于5公斤为散装。

3) 标签注明“产品名称”、“型号”、“净重”、“批号”、“公司名称”、“生产日期”、“注意事项”。

五、使用注意事项

(1) 保存：在3-7℃以内冰箱密封保存，有效期6个月，温度过高和过低对品质均有影响。

(2) 使用：

(a) 锡膏从冰箱中被取出后，置于室温中“回温”不少于3小时左右（禁止在解冻过程中打开锡膏瓶内外盖），充分搅拌3-5分钟，然后印刷；

(b) 锡膏印刷作业环境温度最佳为 25 ± 3 ℃，空气相对湿度30-60%最佳，锡膏印刷后，应尽快完成元器件的贴装，并过炉完成焊接，避免因搁置太久而导致锡膏表面变干，影响元器件贴装及焊接效果，一般建议停留时间不超过8小时。

(c) 焊后残留物极少，且颜色透明，高绝缘阻抗，不必清洗，如客户需清洗，建议使用我司配套的清洗剂清洗。

(d) 经回焊后，若有少量不良焊点，则可用烙铁、锡线、助焊剂进行返修作业，但建议客户在返修时最好使用与本锡膏相兼容的锡线与助焊剂。

推荐炉温曲线

预热升温阶段：25 ~140 ， 0.5~3 /sec

保温阶段： 140 ~160 ， 保持时间60~120sec

快速升温阶段： 160~180 ， 1.5~2.5 /sec

回流阶段： 180 以上时间40~90sec

峰值温度： 205~240

"【企业集采】长先/CX8000LD 免洗有铅锡膏"的用途为元器件焊接，材质是SNPB，加工定制为是